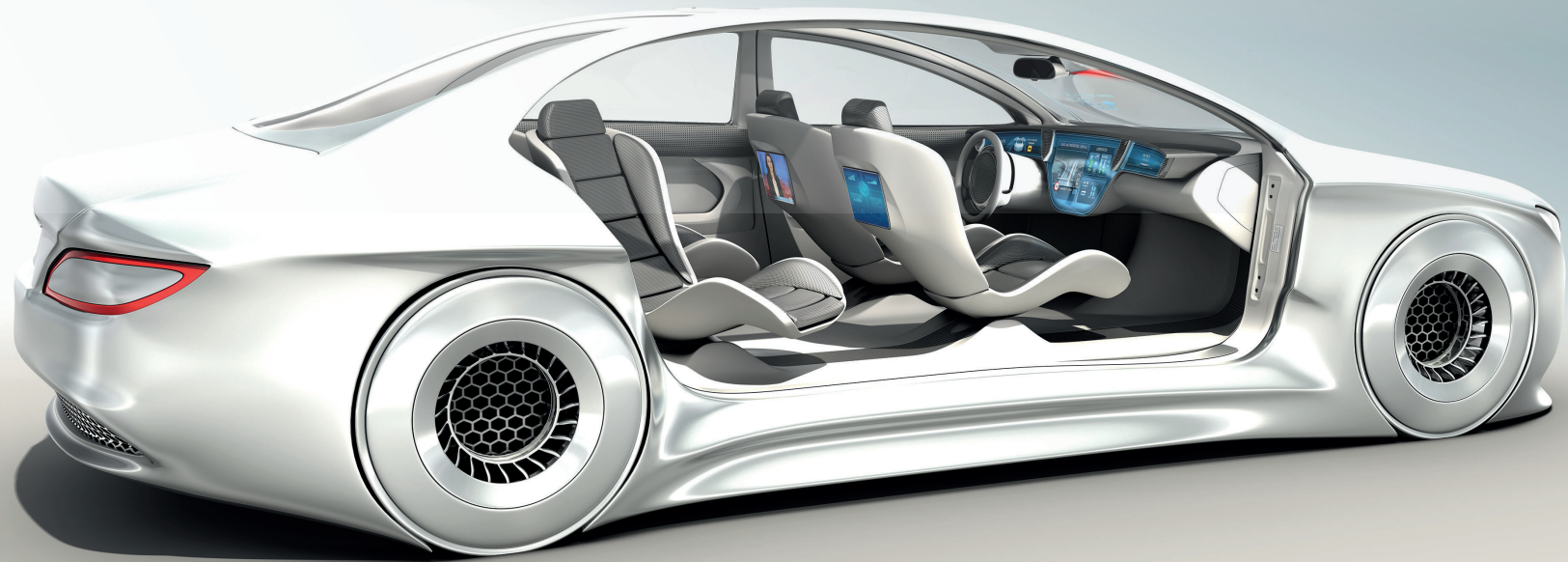


LOCTITE®

同步升级高导热率与高可靠性， 引领行业高标准



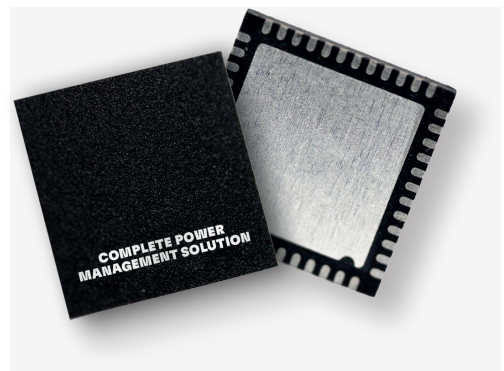
LOCTITE® ABLESTIK ABP 6395T 可向要求严苛的功率芯片应用提供高导热和电气性能。

LOCTITE® ABLESTIK ABP 6395T 是一款导电芯片粘接胶，专为高导热率（~30W/m-K）和高可靠性封装应用而设计。该产品具备优秀的导热率，可用于热管理，同时其出色的导电性可在芯片中实现低导通电阻（RDS(on)）。

在开发过程中，可持续性和安全性被纳入优先考量。该款材料含有低挥发性有机化合物（VOC），并在含银量相对较低的情况下实现优异性能。LOCTITE® ABLESTIK ABP 6395T 支持背面金属化或裸硅(Si)芯片的集成，与铜、银和PPF等多种引线框架表面兼容。

关键应用：

通常推荐用于电机控制、稳压器、电池管理以及消费电子、汽车和工业中其他应用的功率芯片。



Henkel Adhesive Technologies

技术信息

LOCTITE® ABLESTIK ABP 6395T

填料 含有银的环氧树脂

触变指数 (0.5/5 rpm) 6.2

Brookfield粘度 CP51 25°C mPas (cP) 8,500

| | | |
|----------|------|-----|
| 模量 (GPa) | 25°C | 8.1 |
| | 15°C | 1.4 |
| | 25°C | 1.1 |

堆积导热率 (W/m-k) 30.0

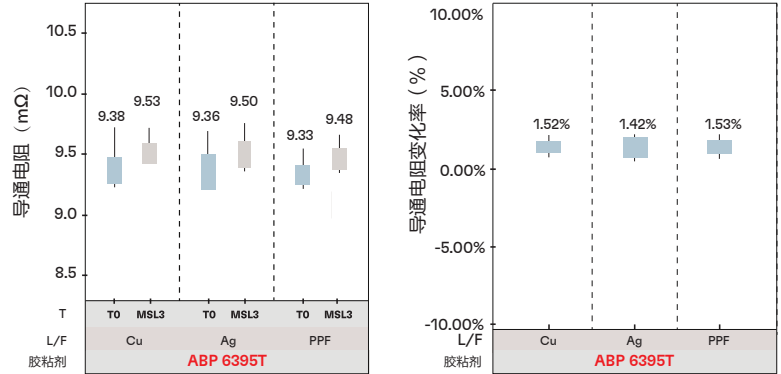
体积电阻率 (Ω-cm) 4.2×10^{-5}

建议固化曲线 30分钟升至200°C
+在200°C氮气或空气中保持30分钟

固化后的失重, TGA(%) 4.1

25°C时的工作寿命 (小时) 24

保存期限 (-40°C) 1年



主要特性和优势:

高可靠性

- 满足车规级可靠性和MSL 1可靠性标准, 适用于尺寸不超过3.0mm×3.0mm的芯片
- 在包括银、铜和PPF在内的多各种基材表面上具有高芯片剪切强度

卓越的导热和电气性能

- 堆积导热率高达30W/m-K
- 出色的导电性和封装内导通电阻性能, 1,000次热循环后导通电阻稳定

可加工性/加工性能

- 不含RBO
- 标准芯片粘接点胶工艺, 没有银沉积或分离
- 24小时稳定一致的点胶性能

健康与安全性

- 与其他高导热芯片粘接胶相比, VOC含量少

您想深入了解汉高专为高可靠性量身设计的高性能导热芯片粘接产品吗?

欢迎联系汉高技术专家, 了解我们的高导热芯片粘接胶材料产品组合。

henkel-adhesives.com/electronics

汉高总部

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstraße 67
40589 Düsseldorf
Germany

电话: (+49) 211 797-0

亚太及大中华区总部

汉高(中国)投资有限公司
中国上海市杨浦区江湾城路99号
尚浦中心7号楼 200438
中国

电话: (+86) 21 2891 800

北美地区

Henkel Corporation
14000 Jamboree Rd
Irvine, CA 92606
United States

电话: (+1) 248 583 9300

此处包含的数据仅供参考。

请联系汉高股份有限及两合公司, 获取有关产品规格的帮助和建议。所有使用的标志均为汉高及其在美国、德国和其他地区的附属公司的商标和/或注册商标。

© 2023 汉高股份有限及两合公司, 保留所有权利。(02/2023)